



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080627001

2008 年 8 月 7 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

DSP製品 C6201X/C6202X/C6701X PB0マスク一部変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	DSP製品 C6201X/C6202X/C6701X PB0マスク一部変更 現行：PB0膜割れ耐性向上 未対応 変更後：PB0膜割れ耐性向上 対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2008 年 11 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは 8 月上旬を予定しています。)			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ90日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) C07プロセスDSP C6201X/C6202X/C6701X製品について、現行 配線層を通常の保護膜にて保護した層の上にPBO(ポリベンゾオキサゾール)膜を最終保護膜として適用しております。今回、弊社での継続的な品質向上の一環として、PBO膜割れ防止及び耐性向上の為に、PBOマスクの一部変更を実施する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
PBO膜割れ耐性向上	未対応	対応

理由: PBO膜割れ防止及び耐性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
TMS320C6201BGJC	TMS320C6201GJCA233	TMS320C6202BGNW3	TMS320C6202GJLA200	TMS320C6701GJC150
TMS320C6201BGJC200	TMS320C6201GJL200	TMS320C6202BGNZ250	TMS320C6202GJLA233	TMS320C6701GJC167
TMS320C6201BGJL	TMS320C6201GJL2001	TMS320C6202BGNZ300	TMS320C6202GJLA250	TMS320C6701GJCA120
TMS320C6201BGJL200	TMS320C6201GJL200B	TMS320C6202BZNY17V	TMS320C6202GLS	TMS320C6701GJCA150
TMS320C6201GGP167	TMS320C6201GJL233	TMS320C6202BZNY250	TMS320C6202GLS200	TMS320C6701GJCA167
TMS320C6201GGP200	TMS320C6201GJLA200	TMS320C6202BZNY300	TMS320C6202GLS250	TMS320C6201GJCA200B
TMS320C6201GJC200	TMS320C6201GJLA233	TMS320C6202BZNY250	TMS320C6202GLS250X	TMS320C6201GJLA200B
TMS320C6201GJC2001	TMS320C6202BGN17V	TMS320C6202BZNY300	TMS320C6202GLSA200	TMS320C6701GJC16719V
TMS320C6201GJC200B	TMS320C6202BGN250	TMS320C6202GJL200	TMS320C6202GLSA250	
TMS320C6201GJC233	TMS320C6202BGN300	TMS320C6202GJL250	TMS320C6701BGJC	
TMS320C6201GJCA200	TMS320C6202BGNW25	TMS320C6202GJL250X	TMS320C6701GJC133	

信頼性試験

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2008 年 8 月 4 日	終了	2008 年 9 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320C6201GJC200		TMS320C6701GJL	
Wafer Fab:	DMOS5		DMOS5	
Wafer Technology:	1833C07.05L		1833C07.05L	
Assembly Site:	TI Philippines (TIPI)		TI Philippines (TIPI)	
Package Type/Code:	BGA / GJC		BGA / GJL	
Package Pins:	35x35mm package, 352 pins		35x35mm package, 352 pins	
Die Bump:	DBUMP		DBUMP	
Substrate:	Kyocera 4208047-0001		Kyocera 4207969-001	
Ball Composition:	SnPb		SnPb	
Lid Attach:	QMI 536HT		QMI 536HT	
Moisture Level:	MSL4/220C		MSL4/220C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		TMS320C6201GJC	TMS3206202GJL	
** Temp Cycle (TC)	-40/125C, 500cys	78	78 (1)	
** Unbiased Hast (UH)	110C/85%RH, 264hrs	78	78 (1)	
** Thermal Shock (TS)	-55/125C, 200cys	78	78 (1)	
Manufacturability (MQ)	Per Assembly mfg. Site specification	3 lots	3 lots (1)	
Moisture Sensitivity	L4, 220C+5/0C - CSAM for delamination	30	30 (1)	
Note:				
** Precon required				
(1) Qualification data of TMS320C6201GJC will be utilized.				